

第11回 LPBフォーラム

LPBフォーマット普及状況

2019年3月8日

株式会社村田製作所
五嶋制二





①村田製作所のサポート状況

②今後の取り組み・課題

①村田製作所のサポート状況

積層セラミックコンデンサのC-Formatライブラリを公開しました
2019年2月28日 ※日本語ページのみ

URL : <https://www.murata.com/ja-jp/tool/c-format>

ホーム > 設計支援ツール > LSI-Package-Board相互設計用C-Format

LSI-Package-Board相互設計用C-Format

積層セラミックコンデンサのC-Formatデータをご提供しております。

当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。

当データの使用に際しての制約事項

- 当データは、電子・電気回路シミュレータ上で当社製品における特性の確認、および電氣的シミュレーションをする目的で使用になれます。それ以外の目的での使用は禁止します。
- 当社は、当データに関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を致しません。特に、商品性、特定の目的に対する適合性及び第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行いません。当データの使用及びその結果に起因若しくは関連して、万ユーザーに損害若しくは第三者との紛争が生じ、又は第三者から損害の請求がなされたとしても、その原因、種類を問わず当社は一切責任を負いません。

※備考
- 当データはIEC 63055/IEEE 2401に準拠した積層セラミックコンデンサのC-Formatのデータです。
- 当データには生産を終了している製品が含まれる場合があります。最新の生産状況については当社へお問い合わせください。

C-Formatの概要についてはこちら (JEITA) [☞](#)
LSI-Package-Board相互設計用Format全般に関するお問い合わせはこちら (JEITA) [☞](#)

更新日 2019/02/28 [ダウンロード](#)

用途	シリーズ	サイズコード	データファイル
<input checked="" type="checkbox"/>	GRM	0201_008004	GRM011R60G103KE01.xml
		0402_01005	GRM011R60G103KE01.mod
			GRM011R60G103KE01.s2p

シリーズ サイズコード データファイル

シリーズ	サイズコード	データファイル
GRM	0201_008004	GRM011R60G103KE01.xml
	0402_01005	GRM011R60G103KE01.mod
		GRM011R60G103KE01.s2p

C-Format
SPICEデータ
Sパラメータ

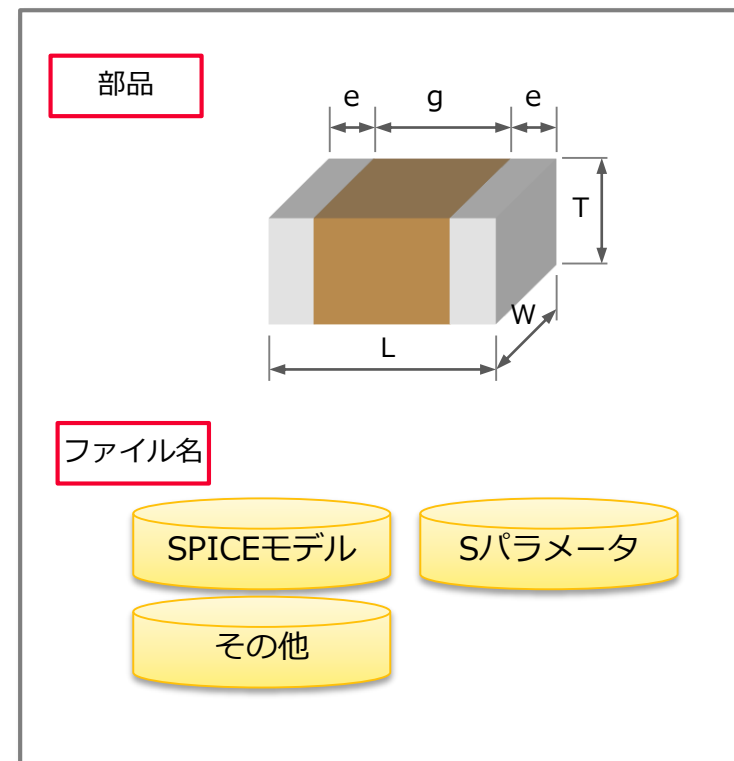
C-Formatの概略

ツール間のデータ流通に必要な情報を記載したデータ(XML形式)

- ・ 部品や外部電極の寸法
- ・ SPICEモデルやSパラメータのファイル名

```
<?xml version="1.0" ?>
<LPB_CFORMAT version="2020">
<header date="June.8 2017" design_revision="1.0"
project="GA2"/>
<global>
  <shape>
    <rectangle height="2" id="1" width="4.5" />
    <rectangle height="2" id="2" width="0.3" />
  </shape>
</global>
. . . . .
<specification>
  <capacitance typ="0.1"/>
</specification>
<reference xmlns:spice="http://www.jeita.or.jp/LPB/spice"
  reffile = "GA242QR7E2102MW01.mod"
  format="SPICE" >
</reference>
<reference
xmlns:touchstone="http://www.jeita.or.jp/LPB/touchstone"
  reffile = "GA242QR7E2102MW01.s2p"
  format="TOUCHSTONE" >
</reference>
</LPB_CFORMAT>
```

※データより一部抜粋



②今後の取り組み・課題

今後の取り組み

- ・データ更新 金属端子付き積層セラミックコンデンサ追加
2019年4月予定
- ・英語ページ公開 2019年6月までに公開予定
- ・弊社WEBページ 情報の追加、改修

課題

- ・データサイズ データ量はzip形式で約185MB／展開後に約 1 GB
GRMシリーズのzipファイルは約120MB
- ・情報発信 海外向け／LPB-SCの英語ページ準備
各EDAツール連携事例
LPB Format全体のエントリーページ
<http://jeita-sdtdc.com/committee-activity/lpbinterface-wg/jeita-lpb-stdformat/>
- ・書式変更への対応 C-Formatのバージョン更新のタイミング



以上